



Speziell entwickelt

- Der führende Anbieter von KI-Infrastrukturen laut Forrester® AI Infrastructure Wave
- 7:1 Konsolidierungsfähig*
- Bis zu 73 % mehr Energieeffizienz*

Intelligent

- Einsparungen von bis zu 50.000 US-Dollar durch Energie- und Managementoptimierung*¹
- 80 % der PowerEdge-Server erreichen das EPEAT Climate+-Siegel¹
- Bis zu 150 Minuten weniger Zeit für das Management pro 100 Servern*¹
- Branchenführendes intelligentes Management
 - iDRAC 10 Integrated Controller und
 - OpenManage Enterprise

Ausfallsicher bei Cyberangriffen

- **3,5-mal** mehr Sicherheitsfunktionen als Mitbewerber*¹
- Unterstützt **Zero Trust**-Einführung
- Werkseitige Sicherheit mit Secured Component Verification

Nachhaltig

- **Auf Effizienz ausgelegt** Die Energieintensität (EI) von PowerEdge-Servern wurde in den letzten 8 Jahren um 83 % reduziert
- **Effizient** Bis zu 73 % mehr Energieeffizienz

PowerEdge R Serie

Rechenzentren stehen heute vor neuen Anforderungen durch KI und brauchen skalierbare, effiziente und leistungsstarke Lösungen, um sowohl Mainstream- als auch beschleunigte Workload-Anforderungen zu bewältigen. In dieser Landschaft zeichnen sich Dell PowerEdge-Rack-Server als eines der führenden Produkte für IT-ExpertInnen und RechenzentrumsmanagerInnen aus, die ihre Infrastruktur transformieren möchten.

Dell PowerEdge-Server der R Serie: Ein umfassendes Lineup an Rack-Servern, das auf die strengen Anforderungen moderner, skalierbarer Rechenzentrumsinfrastruktur ausgelegt ist.



Leistung trifft Flexibilität

Erleben Sie die perfekte Kombination aus Performance, Flexibilität und Energieeffizienz mit unseren fortschrittlichen, zukunftsfähigen Serverdesigns nach Branchenstandard. Diese Server wurden entwickelt, um den Betrieb zu optimieren, senken die Betriebskosten und unterstützen eine nahtlose Skalierbarkeit, sodass Ihr Unternehmen sich schnell an sich ändernde Anforderungen anpassen kann. Durch die Optimierung von Workloads können Sie die Stellfläche Ihres Rechenzentrums reduzieren und gleichzeitig Nachhaltigkeitsziele erreichen, ohne Einbußen bei der erstklassigen Performance hinnehmen zu müssen. Diese Server wurden für die Anforderungen anspruchsvoller Umgebungen entwickelt und bieten erweiterte Funktionen wie flexible und erweiterbare Konfigurationsoptionen, SmartCooling-Lösungen und intelligente Managementtools.

Diese Server eignen sich für komplexe Workloads, Bereitstellungen mit hoher Verfügbarkeit, KI-Aufgaben und Inferenzierungsanwendungen und bieten eine zuverlässige und flexible Grundlage für das Management sich entwickelnder Geschäftsanforderungen. Ihre robusten Funktionen unterstützen ein effizientes Management und betriebliche Kontinuität.



- Fortschrittliche Prozessoren und GPU-Architektur
- Große Arbeitsspeicherkonfigurationen
- I/O-Funktionen mit hoher Bandbreite
- Maßgeschneidert für alle Workloads – von herkömmlichen bis zu KI-intensiven Workloads
- Flexible I/O-Konfigurationen, einschließlich vorder- oder rückseitiger Optionen
- Nach Branchenstandard im DC-MHS-Design (Data Center Modular Hardware Systems) entwickelt

Cybersichere Architektur für Zero-Trust-IT-Umgebung und -Betrieb

Sicherheit ist in jede Phase des PowerEdge-Lebenszyklus integriert, einschließlich geschützter Lieferkette und Integritätsabsicherung von Werk zu Standort. Silicon-basierte Root of Trust Anchors, End-to-End-Startstabilität, während Multifaktor-Authentifizierung (MFA) und rollenbasierte Zugriffskontrollen vertrauenswürdige Vorgänge gewährleisten.

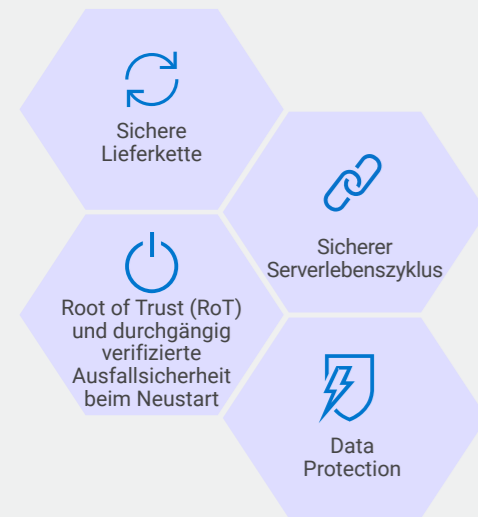
[Mehr erfahren](#)

Produktivitätssteigerung mit Dell System Management Solutions

Vereinfachen Sie das Infrastrukturmanagement mit iDRAC für eine sichere Remote-Serververwaltung, OpenManage Enterprise zur Optimierung des Lebenszyklusmanagements und KI-fähige AIOps zur Optimierung von Infrastruktur und Anwendungen. Automatisieren Sie Aufgaben, erhalten Sie Echtzeitwarnmeldungen und skalieren Sie mühelos, um Produktivität, Performance und Verfügbarkeit zu steigern.

Sicherheit

Integration in jede Phase des Lebenszyklus



Intelligente Stromversorgungs- und Kühlösungen

Stellen Sie sich den wachsenden Herausforderungen im Rechenzentrum, die durch künstliche Intelligenz und dichte Rechenlasten verursacht werden, mit einer Reihe von Lösungen, die Kühlstrategien für Rechenzentren verbessern, die Systemleistung optimieren und es Unternehmen ermöglichen, ein Gleichgewicht zwischen Effizienz, Leistung und Nachhaltigkeit herzustellen.

Fachkundige Unterstützung durch Dell Technologies Services

Optimieren Sie die Leistung bei jedem Schritt mit Services, die von der schnellen, nahtlosen Bereitstellung mit der ProDeploy Infrastructure Suite, einschließlich KI-spezifischer Setups, bis hin zum proaktiven, rund um die Uhr verfügbaren Support mit ProSupport Plus reichen. Darüber hinaus bieten unsere Beratungs- und Managed Services einen noch größeren Mehrwert, indem sie maßgeschneiderte Strategien zur Rationalisierung von Abläufen und zur Verbesserung der Effizienz anbieten und Ihnen dabei helfen, Ihre individuellen Geschäftsziele mit Zuversicht zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter Dell.com/Services oder wenden Sie sich noch heute an Ihr Dell Vertriebsteam.

Sorgenfrei mit Dell Technologies Services

ProSupport Plus for Infrastructure

- Unterstützt mit proaktivem und vorausschauendem Support den dauerhaften Betrieb Ihrer Server
- Profitieren Sie von einer persönlichen Kundenvertretung, die sich rund um die Uhr auf Ihre gewünschten Ergebnisse konzentriert
- Durch die Zusammenarbeit mit Drittanbietern und einem Notfallreaktionsteam bei Problemen vom Schweregrad 1 sind Sie auf der sicheren Seite

Für maximale Sicherheit und Effizienz: Optimieren Sie Ihre Server mit den Beratungs-, Implementierungs- und Managed Services von Dell Technologies

Dell Produkte, die gemeinsam noch mehr Leistung bringen

Hochfahren der IP-Fabric der nächsten Generation mit 100/400-GbE-Open-Networking der zweiten Generation. Der PowerSwitch S5448F-ON verfügt über 48 x 100-GbE-SFP56-DD-Ports und 8 x 400-GbE-QSFP56-DD-Ports und bietet ein breites Spektrum an Funktionen, um die wachsenden Anforderungen der heutigen Rechenzentrums Umgebung zu erfüllen. Dell PowerVault – PowerVault bietet SAN-/DAS-Lösungen, die die Kapazitätserweiterung für PowerEdge-Server vereinfachen

Dell Produkte, die besser zusammenarbeiten















Hochfahren der IP-Fabric der nächsten Generation mit 100/400-GbE-Open-Networking der zweiten Generation. Der Dell PowerSwitch Z9432F-ON bietet 32 Anschlüsse mit 400 GbE in einem einzigen Switch.



Der PowerSwitch S5448F-ON verfügt über 48 100-GbE-SFP56-DD-Anschlüsse sowie 8 400-GbE-QSFP56-DD-Anschlüsse und bietet ein breites Funktionsangebot. Auf diese Weise werden die wachsenden Anforderungen heutiger Rechenzentrums Umgebungen erfüllt.

Dell PowerVault – PowerVault bietet SAN/DAS-Lösungen, die die Kapazitätserweiterung für PowerEdge-Server vereinfachen

Dieses Dokument enthält eine umfassende Liste der Produktfunktionen. Funktionen, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind jedoch möglicherweise bei der Einführung nicht verfügbar, werden aber in zukünftigen Updates eingeführt. Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit oder der Veröffentlichungszeitplan einer Funktion in diesem Dokument nicht bestätigt wird. Die genauesten und aktuellsten Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter [dell.com](https://www.dell.com).

Funktion	R470	R570	R670	R770	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R770AP	R4715	R5715
Systeme												
Prozessor	<ul style="list-style-type: none"> Ein Intel® Xeon® 6 E-Core Prozessor mit bis zu 144 Cores Ein Intel® Xeon® 6 P-Core Prozessor mit bis zu 86 Cores und R1S-Option 	<ul style="list-style-type: none"> Ein Intel® Xeon® 6 E-Core Prozessor mit bis zu 144 Cores Ein Intel® Xeon® 6 P-Core Prozessor mit bis zu 86 Cores und R1S-Option 	Zwei Intel Xeon 6 Prozessoren mit bis zu 144 Cores oder 86 P-Cores pro Prozessor	Zwei Intel Xeon 6 Prozessoren mit bis zu 144 Cores oder 86 P-Cores pro Prozessor	Ein AMD EPYC 9005 Serie-Prozessor der 5. Generation mit bis zu 160 Cores pro Prozessor	Ein AMD EPYC 9005 Serie-Prozessor der 5. Generation mit bis zu 160 Cores pro Prozessor	Zwei AMD EPYC 9005 Serie-Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 192* Cores pro Prozessor	Zwei AMD EPYC 9005 Serie-Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 192* Cores pro Prozessor	Zwei AMD EPYC 9005 Serie-Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 192* Cores pro Prozessor	Zwei Intel® Xeon® 6 Prozessoren der 6900 Serie mit P-Cores und jeweils bis zu 128 Cores.	1 AMD EPYC 9005 Serie-Prozessor der 5. Generation mit bis zu 32 Cores pro Prozessor	1 AMD EPYC 9005 Serie-Prozessor der 5. Generation mit bis zu 32 Cores pro Prozessor
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> 16 DDR5 DIMM-Steckplätze, RDIMM mit max. 4 TB*, Geschwindigkeiten von bis zu 6.400 MT/s Intel® Xeon® 6 E-Core Prozessor – unterstützt max. 1 TB Intel® Xeon® 6 P-Core-Prozessor mit bis zu 86 Cores mit R1S-Option – max. 4 TB Unterstützt nur registrierte ECC DDR5-DIMMs <p>Hinweis: Der installierte Prozessor kann die Betriebsgeschwindigkeit des DIMM verringern</p>	<ul style="list-style-type: none"> 16 DDR5 DIMM-Steckplätze, Geschwindigkeiten von bis zu 6.400 MT/s Ein Intel® Xeon® 6 E-Core Prozessor – unterstützt RDIMM mit max. 1 TB Ein Intel® Xeon® 6 P-Core Prozessor mit bis zu 86 Cores und R1S-Option – unterstützt RDIMM, max. 4 TB* Unterstützt nur registrierte ECC-DDR5-DIMMs Unterstützt nur registrierte ECC-DDR5-DIMMs 	<ul style="list-style-type: none"> 32 DDR5 DIMM-Steckplätze, unterstützt RDIMM mit max. 8 TB, Geschwindigkeiten von bis zu 6.400 MT/s Unterstützt nur registrierte ECC DDR5-DIMMs 	<ul style="list-style-type: none"> 32 DDR5 DIMM-Steckplätze, unterstützt RDIMM mit max. 8 TB, Geschwindigkeiten von bis zu 6.400 MT/s Unterstützt nur registrierte ECC DDR5-DIMMs 	<ul style="list-style-type: none"> 24 DDR5 DIMM-Steckplätze, unterstützt RDIMM mit max. 6 TB, Geschwindigkeiten von bis zu 5200 MT/s Unterstützt nur registrierte ECC DDR5-DIMMs 	<ul style="list-style-type: none"> 24 DDR5 DIMM-Steckplätze, unterstützt RDIMM mit max. 6 TB, Geschwindigkeiten von bis zu 5200 MT/s Unterstützt nur registrierte ECC DDR5-DIMMs 	<ul style="list-style-type: none"> 24 DDR5 DIMM-Steckplätze, unterstützt RDIMM mit max. 6 TB, Geschwindigkeiten von bis zu 6.400 MT/s Unterstützt nur registrierte ECC DDR5-DIMMs 	<ul style="list-style-type: none"> 24 DDR5 DIMM-Steckplätze, unterstützt RDIMM mit max. 6 TB, Geschwindigkeiten von bis zu 6.400 MT/s Unterstützt nur registrierte ECC DDR5-DIMMs 	<ul style="list-style-type: none"> 24 DDR5 DIMM-Steckplätze, unterstützt RDIMM mit max. 3 TB, Geschwindigkeiten von bis zu 6.400 MT/s Unterstützt nur registrierte ECC DDR5-DIMMs 	<ul style="list-style-type: none"> 24 DDR5 DIMM-Steckplätze, unterstützt RDIMM mit max. 3 TB, Geschwindigkeiten von bis zu 6.400 MT/s Unterstützt nur registrierte ECC DDR5-DIMMs 	<ul style="list-style-type: none"> 24 DDR5-DIMM-Steckplätze mit Unterstützung für RDIMM, bis zu 64 GB pro DIMM, maximale Arbeitsspeicherkapazität von 1,5 TB, Geschwindigkeiten von bis zu 5200 MT/s. Unterstützt nur registrierte ECC DDR5-DIMMs. 	<ul style="list-style-type: none"> 24 DDR5-DIMM-Steckplätze mit Unterstützung für RDIMM, bis zu 64 GB pro DIMM, maximale Arbeitsspeicherkapazität von 1,5 TB, Geschwindigkeiten von bis zu 5200 MT/s. Unterstützt nur registrierte ECC DDR5-DIMMs.
Storage-Controller	<ul style="list-style-type: none"> Interne Controller (RAID): PERC H365i DC-MHS, PERC H965i DC-MHS vorne, PERC H365i-Adapter, PERC H965i-Adapter Externe Controller: HBA465e, H965e (RAID) Interner Start: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWRaid 1, 2 x M.2 NVMe-SSDs oder M.2-Interposer Platine mit bis zu 2 x M.2 NVMe-SSDs, USB 	<ul style="list-style-type: none"> Interne Controller (RAID): PERC H365i DC-MHS, PERC H965i DC-MH, PERC H365i-Adapter, PERC H965i-Adapter Internes Bootsystem: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS), M.2-Interposer-Platine mit bis zu 2 x M.2 NVMe-SSDs, USB Externe Controller: PERC H965e, HBA 465e 	<ul style="list-style-type: none"> Interner Start: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWRaid 1, 2 x M.2 NVMe-SSDs oder M.2-Zwischenplatine (DC-MHS): 2 x M.2 NVMe-SSDs oder USB Interne Controller: PERC H965i vorne, PERC H975i vorne, PERC H365i vorne 	<ul style="list-style-type: none"> Interner Start: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWRaid 1, 2 x M.2 NVMe-SSDs oder M.2-Zwischenplatine (DC-MHS): 2 x M.2 NVMe-SSDs oder USB Interne Controller: PERC H965i vorne, PERC H975i vorne, PERC H365i vorne 	<ul style="list-style-type: none"> Interne Controller (RAID): PERC H365i, H965i, H975i Interner Start: Bootoptimiertes Storage-Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) Externe HBAs (nicht-RAID): HBA465e 	<ul style="list-style-type: none"> Interne Controller (RAID): PERC H365i, H965i, H975i Interner Start: Bootoptimiertes Storage-Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) Externe HBAs (nicht-RAID): HBA465e 	<ul style="list-style-type: none"> Interne Controller (RAID): PERC H365i, H965i, H975i Interner Start: Bootoptimiertes Storage-Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) Externe HBAs (nicht-RAID): HBA465e 	<ul style="list-style-type: none"> Interne Controller (RAID): PERC H365i, H965i, H975i Interner Start: Bootoptimiertes Storage-Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) Externe HBAs (nicht-RAID): HBA465e 	<ul style="list-style-type: none"> Interne Controller (RAID): k. A. Interner Start: Bootoptimiertes Storage-Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) Externe HBAs (nicht-RAID): n/z 	<ul style="list-style-type: none"> Internes Bootsystem: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWRaid 1, 2 x M.2 NVMe-SSDs oder USB Interne Controller: PERC H975i DC-MHS vorn Externe HBAs (nicht-RAID): n/z 	<ul style="list-style-type: none"> Interne Controller (RAID): PERC H365i, H965i Interner Start: Bootoptimiertes Storage-Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) Externe HBAs (nicht-RAID): n/z 	<ul style="list-style-type: none"> Interne Controller (RAID): PERC H365i, H965i Interner Start: Bootoptimiertes Storage-Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) Externe HBAs (nicht-RAID): n/z

Funktion	R470	R570	R670	R770	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R770AP	R4715	R5715
Laufwerk-schächte	<p>Vordere Schächte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bis zu 8 x EDSFF E3.S Gen5-NVMe, max. 491,52 TB Bis zu 16 x EDSFF E3.S Gen5-NVMe, max. 983,04 TB Bis zu 8 x 2,5-Zoll-SATA/NVMe mit max. 491,52 TB Bis zu 10 x 2,5-Zoll SATA/NVMe (mit 4 x 2,5-Zoll-Universal), max. 614,4 TB Max. 4 x 3,5-Zoll-SATA mit max. 128 TB (wird nur mit 2 x E3.S-Laufwerken auf der Rückseite unterstützt; nicht als eigenständige Frontkonfiguration unterstützt) <p>Hinterere Schächte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bis zu 2 x EDSFF E3.S Gen5-NVMe, max. 122,88 TB 	<p>Vordere Schächte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bis zu 12 x 3,5"-SATA-RAID (HDD), max. 384 TB* Bis zu 8 x 2,5 Zoll NVMe RAID, max. 491,52 TB Bis zu 8 x 2,5"-NVMe, max. 491,52 TB Bis zu 8 x 2,5-Zoll-SAS, max. 30,72 TB Bis zu 8 x 2,5-Zoll-SATA/Universal, max. 491,52 TB Bis zu 16 x 2,5-Zoll-SATA/RAID, max. 61,44 TB Bis zu 24 x 2,5" SATA, max. 92,16 TB Bis zu 8 x EDSFF-E3.S-Gen5-NVMe (Warmgang), max. 491,52 TB Bis zu 8 x EDSFF-E3.S-Gen5-NVMe (Kaltgang), max. 491,52 TB Bis zu 16 x EDSFF-E3.S-Gen5-NVMe (Kaltgang), max. 983,04 TB Bis zu 16 x EDSFF-E3.S-Gen5-NVMe (Warmgang), max. 983,04 TB Bis zu 32 x EDSFF-E3.S-Gen5-NVMe (Warmgang), max. 1966,08 TB <p>Hinterere Schächte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bis zu 4 x EDSFF E3.S Gen5-NVMe, max. 245,76 TB 	<ul style="list-style-type: none"> Konfiguration ohne Rückwandplatine Bis zu 8 x EDSFF E3.S NVMe, max. 491,52 TB, auch mit FIO-Konfiguration Bis zu 16 x EDSFF E3.S Gen5-NVMe, max. 983,04 TB Bis zu 20 x EDSFF E3.S Gen5-NVMe, max. 1228,8 TB Bis zu 8 x 2,5"-SATA/NVMe Direct/NVMe Raid, max 491,52 TB Bis zu 8 x 2,5" Universal 491,52 TB Bis zu 10 x 2,5"-SATA, max. 38,4 TB <p>Hinterere Schächte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bis zu 2 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe auf der Rückseite, max. 122,88 TB 	<ul style="list-style-type: none"> Konfiguration ohne Rückwandplatine Bis zu 8 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe, max. 491,52 TB, auch mit FIO-Konfiguration Bis zu 16 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe, max. 983,04 TB, auch mit FIO-Konfiguration Bis zu 32 x EDSFF E3.S Gen5-NVMe, max. 1966,08 TB Bis zu 8 x 2.5"-SATA/NVMe, max 491,52 TB Bis zu 8 x 2,5" Universal, max. 491,52 TB Bis zu 16 x 2,5"-SATA, max. 61,44 TB Bis zu 24 x 2,5"-SATA, max. 92,16 TB Bis zu 16 x 2,5"-SATA + 8 x 2,5"-NVMe, max. 552,96 TB Bis zu 40 x EDSFF E3.S Gen5-NVMe, max. 2457,6 TB <p>Hinterere Schächte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bis zu 4 x EDSFF E3.S Gen5 NVMe, max. 245,76 TB auf der Rückseite 	<p>Vordere Schächte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA 8 x 2,5-Zoll Universal oder U.2 / 10 x 2,5-Zoll-SAS/SATA 10 x 2,5-Zoll mit 4 universellen Steckplätzen 16 EDSFF-E3.S-Gen5-NVMe-Laufwerke 20 x EDSFF E3.S + hinten 2 x EDSFF E3.S 	<p>Vordere Schächte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 x U.2-SSDs 12 x 3,5-Zoll-SAS/SATA 8 x 2,5" Universal / 16 x 2,5"-SAS/SATA / 24 x 2,5"-SAS/SATA 16 2,5"-SAS-/SATA-SSD+ 8 U.2-NVMe-Laufwerke 8 EDSFF E3.S / 16 EDSFF E3.S / 32 EDSFF E3.S / 40 EDSFF E3.S 	<p>Vordere Schächte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 3,5-Zoll-SAS/SATA 8 x 2,5-Zoll Universal oder U.2 / 10 x 2,5-Zoll-SAS/SATA 10 x 2,5-Zoll mit 4 universellen Steckplätzen 8 EDSFF E3.S / 16 EDSFF E3.S / 20 EDSFF E3.S / hinten 2 EDSFF E3.S 	<p>Vordere Schächte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 x 3,5-Zoll-SAS/SATA 8 x 2,5" Universal / 16 x 2,5"-SAS/SATA / 24 x 2,5"-SAS/SATA 16 x 2,5-Zoll-SAS/SATA + 8 x U.2 oder 2,5-Zoll-NVMe RAID 8 EDSFF E3.S / 16 EDSFF E3.S / 32 EDSFF E3.S / 40 EDSFF E3.S 	<p>Vordere Schächte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 24 x 2,5" U.2 Gen5 NVMe (SSD), max. 2.928 TB 	<ul style="list-style-type: none"> Konfiguration ohne Rückwandplatine Bis zu 8 x 2,5-Zoll-NVMe G5 x4 (SSD), max. 122,88 TB Bis zu 16 x 2,5-Zoll-NVMe G5 x4 (SSD), max. 245,76 TB Bis zu 16 x 2,5-Zoll-NVMe G5 x2 (SSD), max. 245,76 TB Bis zu 32 x EDSFF E3.S Gen5-NVMe (SSD), max. 491,52 TB <p>Anschlüsse auf der Rückseite: k. A.</p>	<p>Vordere Schächte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 3,5"-SAS 8 x 2,5"-SAS/SATA 8 x U.2 NVMe G4 	<p>Vordere Schächte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 x 3,5"-SAS/SATA 16 x 2,5"-SAS/SATA
Netzteile	<ul style="list-style-type: none"> 800 W Platinium/Titanium, 100 bis 240 VAC oder 240 HVDC, Hot-Swap-fähig, redundant 1100 W Platinium/Titanium, 100 bis 240 VAC oder 240 HVDC, Hot-Swap-fähig, redundant 1500 W Titanium 100–240 V Wechselstrom oder 240 HVDC (Hochvolt-Gleichstrom), Hot-Swap-fähig und redundant 1.500 W, 277 VAC und HVDC Titanium, Hot-Swap-fähig, redundant* 1400 W, -48v DC Titanium, Hot-Swap-fähig, redundant 1.800 W Titanium, 100 bis 240 VAC oder 240 HVDC, Hot-Swap-fähig, redundant* 	<ul style="list-style-type: none"> 800 W Platinium/Titanium, 100 bis 240 VAC oder 240 HVDC, Hot-Swap-fähig, redundant 1100 W Platinium/Titanium, 100 bis 240 VAC oder 240 HVDC, Hot-Swap-fähig, redundant 1500 W Titanium 100–240 V Wechselstrom oder 240 HVDC (Hochvolt-Gleichstrom), Hot-Swap-fähig und redundant 1.500 W, 277 VAC und HVDC Titanium, Hot-Swap-fähig, redundant* 1.400 W, -48 VDC, Hot-Swap-fähig, redundant 1.800 W Titanium, 100 bis 240 VAC oder 240 HVDC, Hot-Swap-fähig, redundant* 	<ul style="list-style-type: none"> 1.500 W Titanium, 100–240 VAC oder 240 VDC 1100 W Titanium, 100–240 VAC oder 240 VDC 800 W Titanium, 100–240 VAC oder 240 VDC 1.800 W HLAC Titanium, 200–240 VAC oder 240 VDC* 1100 W Platinium 100–240 VAC oder 240 VDC 800 W Platinium 100–240 VAC oder 240 VDC 1.500 W, 277 VAC oder 336 VDC* 1.400 W LVDC, -48 bis -60 VDC 	<ul style="list-style-type: none"> 800 W Platinium 100–240 VAC oder 240 VDC 1.100 W Platinium 100–240 VAC oder 240 VDC 1.500 W Titanium, 100–240 VAC oder 240 VDC 1100 W Titanium, 100–240 VAC oder 240 VDC 3200 W Titanium, 200–240 VAC oder 240 VDC 800 W Titanium, 100–240 VAC oder 240 VDC 3.200 W 277 VAC und 336 HVDC Titanium 1400 W – 48 VDC 60 mm 1500 W 277 VAC und 336 HVDC Titanium* 2400 W Titanium, 100–240 VAC oder 240 VDC* 1.800 W HLAC Titanium, 200–240 VAC oder 240 VDC* 	<ul style="list-style-type: none"> Platinium 800 W, 1.100 W Titanium: 800 W, 1.100 W, 1.500 W, 1.500 W 277 VAC und HVDC*, 1.800 W* Telco: 1400 W -48 VDC 	<ul style="list-style-type: none"> Platinium 800 W, 1.100 W Titanium: 800 W*, 1100 W*, 1500 W, 1500 W 277 VAC und HVDC*, 1800 W*, 2400 W*, 3200 W*, 3200 W 277 VAC und HVDC Telco: 1400 W -48 VDC 	<ul style="list-style-type: none"> Platinium 800 W, 1.100 W Titanium: 800 W, 1.100 W, 1.500 W, 1.500 W 277 VAC und HVDC*, 1.800 W* Telco: 1400 W -48 VDC 	<ul style="list-style-type: none"> Platinium 800 W, 1.100 W Titanium: 800 W*, 1100 W*, 1500 W, 1500 W 277 VAC und HVDC*, 1800 W*, 2400 W*, 3200 W*, 3200 W 277 VAC und HVDC Telco: 1400 W -48 VDC 	<ul style="list-style-type: none"> 1500 W Titanium, 100 bis 240 VAC oder 240 HVDC, Hot-Swap-fähig, redundant 1.800 W Titanium, 200 bis 240 VAC oder 240 HVDC, Hot-Swap-fähig, redundant* 2400 W Titanium, 100 bis 240 VAC oder 240 HVDC, Hot-Swap-fähig, redundant* 3200 W Titanium 200–240 V Wechselstrom oder 240 HVDC (Hochvolt-Gleichstrom), Hot-Swap-fähig und redundant 	<ul style="list-style-type: none"> 1500 W Titanium, 100 bis 240 VAC oder 240 HVDC, Hot-Swap-fähig, redundant 1800 W Titanium 200–240 V Wechselstrom oder 240 HVDC (Hochvolt-Gleichstrom), Hot-Swap-fähig und redundant 2400 W Titanium, 100 bis 240 VAC oder 240 HVDC, Hot-Swap-fähig, redundant 3200 W Titanium 200–240 V Wechselstrom oder 240 HVDC (Hochvolt-Gleichstrom), Hot-Swap-fähig und redundant 3200 W, 277 VAC und 336 HVDC Titanium, Hot-Swap-fähig, redundant* 	<ul style="list-style-type: none"> Platinium 800 W, 1100 W Titanium: 800 W, 1100 W FTR-Unterstützung 	<ul style="list-style-type: none"> Platinium 800 W, 1100 W Titanium: 800 W, 1100 W FTR-Unterstützung

Funktion	R470	R570	R670	R770	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R770AP	R4715	R5715
Integrationen und Verbindungen	OpenManage Integrations • Redhat Ansible Collections • Terraform-Anbieter	OpenManage Integrations • Redhat Ansible Collections • Terraform-Anbieter	OpenManage Integrations • Redhat Ansible Collections • Terraform-Anbieter	OpenManage Integrations • Redhat Ansible Collections • Terraform-Anbieter	OpenManage Integrations • Redhat Ansible Collections • Terraform-Anbieter	OpenManage Integrations • Redhat Ansible Collections • Terraform-Anbieter	OpenManage Integrations • Redhat Ansible Collections • Terraform-Anbieter	OpenManage Integrations • Redhat Ansible Collections • Terraform-Anbieter	OpenManage Integrations • Redhat Ansible Collections • Terraform-Anbieter	OpenManage Integrations • Redhat Ansible Collections • Terraform-Anbieter	OpenManage Integrations • Redhat Ansible Collections • Terraform-Anbieter	OpenManage Integrations • Redhat Ansible Collections • Terraform-Anbieter
Änderungsmanagement	• Dell Repository Manager • Dell System Update • Enterprise-Kataloge • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Dell System Update • Enterprise-Kataloge • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Dell System Update • Enterprise-Kataloge • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Dell System Update • Enterprise-Kataloge • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Dell System Update • Enterprise-Kataloge • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Dell System Update • Enterprise-Kataloge • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Dell System Update • Enterprise-Kataloge • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Dell System Update • Enterprise-Kataloge • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Dell System Update • Enterprise-Kataloge • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Dell System Update • Enterprise-Kataloge • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Dell System Update • Enterprise-Kataloge • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Dell System Update • Enterprise-Kataloge • Server Update Utility (SUU)*
Sicherheit	• Kryptografisch signierte Firmware • Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement) • Secure Boot • Gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) • Secure Erase • Silicon Root of Trust • Systemsperre (iDRAC10 Enterprise oder Datacenter erforderlich) • TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert • Gehäuseeingriffserkennung	• Kryptografisch signierte Firmware • Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement) • Secure Boot • Gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) • Secure Erase • Silicon Root of Trust • Systemsperre • TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert • Gehäuseeingriffserkennung	• Kryptografisch signierte Firmware • Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement) • Secure Boot • Gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) • Secure Erase • Silicon Root of Trust • Systemsperre • TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert • Gehäuseeingriffserkennung	• Kryptografisch signierte Firmware • Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement) • Secure Boot • Gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) • Silicon Root of Trust • Systemsperre (iDRAC10 Enterprise oder Datacenter erforderlich) • Gehäuseeingriffserkennung • TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert	• Kryptografisch signierte Firmware • Data-at-Rest-Verschlüsselung (SED mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement) • Secure Boot • Gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) • Secure Erase • Silicon Root of Trust • Systemsperre • TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert • Gehäuseeingriffserkennung	• AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) • AMD Secure Memory Encryption (SME) • Kryptografisch signierte Firmware • Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement) • Secure Boot • Gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) • Secure Erase • Silicon Root of Trust • Systemsperre (iDRAC10 Enterprise oder Datacenter erforderlich) • Secure Erase • Silicon Root of Trust • Systemsperre • TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert • Gehäuseeingriffserkennung	• Kryptografisch signierte Firmware • Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement) • Secure Boot • Gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) • Secure Erase • Silicon Root of Trust • Systemsperre • TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert • Gehäuseeingriffserkennung	• Kryptografisch signierte Firmware • Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement) • Secure Boot • Gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) • Secure Erase • Silicon Root of Trust • Systemsperre • TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert • Gehäuseeingriffserkennung	• Kryptografisch signierte Firmware • Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement) • Secure Boot • Gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) • Secure Erase • Silicon Root of Trust • Systemsperre • TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert • Gehäuseeingriffserkennung	• Kryptografisch signierte Firmware • Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement) • Secure Boot • Gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) • Secure Erase • Silicon Root of Trust • Systemsperre (iDRAC10 Enterprise oder Datacenter erforderlich) • TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert • Gehäuseeingriffserkennung	• Kryptografisch signierte Firmware • Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement) • Secure Boot • Gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) • Secure Erase • Silicon Root of Trust • Systemsperre (iDRAC10 Enterprise oder Datacenter erforderlich) • TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert • Gehäuseeingriffserkennung	• AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) • AMD Secure Memory Encryption (SME) • Kryptografisch signierte Firmware • Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement) • Secure Boot • Gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) • Secure Erase • Silicon Root of Trust • Systemsperre • TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert • Gehäuseeingriffserkennung
OCP-Netzwerkoptionen	• Bis zu zwei OCP NIC-Karten 3.0: Zwei Steckplätze auf der Vorderseite oder zwei Steckplätze auf der Rückseite (optional) Steckplatz 2: 1 x 16 OCP 3.0 Steckplatz 5: 1 x16 OCP 3.0 Steckplatz 31: 1 x16 OCP 3.0 Steckplatz 32: 1 x16 OCP 3.0	• Bis zu zwei OCP NIC-Karten 3.0: Zwei Steckplätze auf der Vorderseite oder zwei Steckplätze auf der Rückseite (optional) Steckplatz 4: 1 x 16 OCP 3.0 Steckplatz 10: 1 x16 OCP 3.0 Steckplatz 34: 1 x16 OCP 3.0 Steckplatz 38: 1 x16 OCP 3.0	4 x OCP NIC 3.0-Karten (optional) und 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE und 400 GbE* Steckplatz 31 1 x 16 OCP 3.0 auf dem vorderen Riser Steckplatz 32 1 x 16 OCP 3.0 auf dem vorderen Riser Steckplatz 2 1 x 16 OCP 3.0 Steckplatz 5 1 x 8 Gen5 OCP 3.0 oder 1 x 16 Gen5 OCP 3.0	4 x OCP NIC 3.0-Karten (optional) und 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE und 400 GbE* Steckplatz 4: 1 x8 oder 1 x16 Gen5 OCP 3.0 Steckplatz 10: 1 x8 oder 1 x16 OCP 3.0 Steckplatz 34 1 x 16 Gen5 OCP 3.0 auf dem vorderen Riser Steckplatz 38 1 x 16 Gen5 OCP 3.0 auf dem vorderen Riser	• 2 x OCP-Karte 3.0 (optional) und 1 GbE*, 10 GbE*, 25 GbE, 100 GbE und 400 GbE • Steckplatz 2: 1 x16 Gen5 OCP 3.0 • Steckplatz 5: 1 x16 Gen5 OCP 3.0	2 x OCP NIC 3.0-Karte (optional) mit 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE und 400 GbE • Steckplatz 4: 1 x16 Gen 5 OCP 3.0 • Steckplatz 10: 1 x16 Gen 5 OCP 3.0	2 x OCP-Karte 3.0 (optional) und 1 GbE*, 10 GbE*, 25 GbE, 100 GbE und 400 GbE • Steckplatz 2: 1 x 16 Gen 5 OCP 3.0 • Steckplatz 5: 1 x 16 Gen 5 OCP 3.0	• 2 x OCP NIC 3.0-Karte (optional) mit 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE und 400 GbE • Steckplatz 4: 1 x16 Gen 5, 2. OCP 3.0 • Steckplatz 10: 1 x16 Gen 5 OCP 3.0	• 1 x OCP NIC 3.0 Gen 3 (optional); 10 GbE • Steckplatz 10: 1 x4 Gen 3 OCP 3.0	• 2 x OCP NIC 3.0-Karte (optional) mit 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE und 200 GbE • Steckplatz 4: 1 x8 oder 1 x16 Gen5 OCP 3.0 • Steckplatz 10: 1 x16 Gen 5 OCP 3.0	• 2 x OCP 3.0-Karte (optional) mit 1 GbE, 10 GbE und 25 GbE • Steckplatz 2: 1 x 16 Gen 5 OCP 3.0 • Steckplatz 5: 1 x 16 Gen 5 OCP 3.0	• 2 x OCP NIC 3.0-Karte (optional) mit 1 GbE, 10 GbE und 25 GbE • Steckplatz 4: 1 x16 Gen 5 OCP 3.0 • Steckplatz 10: 1 x16 Gen 5 OCP 3.0
BOSS	Steckplatz 34: 1 x 4 BOSS Steckplatz 3: 1 x 4 BOSS	Steckplatz 34: 1 x 4 BOSS Steckplatz 6: 1 x 4 BOSS	Steckplatz 34 1 x 4 BOSS Steckplatz 3 1 x 4 BOSS	Steckplatz 34: 1 x 4 BOSS Steckplatz 6: 1 x 4 BOSS	Steckplatz 3: 1 x 4 BOSS	Steckplatz 6: 1 x 4 BOSS	Steckplatz 3: 1 x 4 BOSS	Steckplatz 6: 1 x 4 BOSS	Steckplatz 6: 1 x 4 BOSS	Steckplatz 6: 1 x 4 BOSS	Steckplatz 3: 1 x 4 BOSS	Steckplatz 6: 1 x 4 BOSS
Integrierter NIC	1 Gb dedizierter BMC-Ethernetanschluss	1 Gb dedizierter BMC-Ethernetanschluss	1 Gb dedizierter BMC-Ethernetanschluss	1 Gb dedizierter BMC-Ethernetanschluss	1 Gb dedizierter BMC-Ethernetanschluss	1 Gb dedizierter BMC-Ethernetanschluss	1 Gb dedizierter BMC-Ethernetanschluss	1 Gb dedizierter BMC-Ethernetanschluss	1 Gb dedizierter BMC-Ethernetanschluss	1 Gb dedizierter BMC-Ethernetanschluss	1 Gb dedizierter BMC-Ethernetanschluss	1 Gb dedizierter BMC-Ethernetanschluss
NIC für PCIe-Add-in-Karte (AIC)	-	-	-	-	100 GbE und 400 GbE; NDR VPI (400 GbE); FC 32	100 GbE und 400 GbE; NDR VPI (400 GbE); FC 32	100 GbE und 400 GbE NDR VPI (400 GbE); FC 32 / 64	100 GbE und 400 GbE NDR VPI (400 GbE); FC 32 / 64	100 GbE und 400 GbE; NDR VPI (400 GbE)	-	100 GbE und 400 GbE; NDR VPI (400 GbE); FC 32	100 GbE und 400 GbE; NDR VPI (400 GbE); FC 32

Funktion	R470	R570	R670	R770	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R770AP	R4715	R5715		
GPU-Optionen	Bis zu 4 x 75 W (SW)	Bis zu 3 x 400 W (DW); bis zu 4 x 75 W (SW)	Bis zu 3 x 75 W SW	Bis zu 6 x 75 W FHHL* oder bis zu 2 x 450 W DWFL	Bis zu 3 x 75 W SW	Bis zu 3 x 450 W DW*; bis zu 6 x 75 W SW	Bis zu 3 x 75 W SW	Bis zu 2 x 450 W (DW)*; bis zu 6 x 75 W (SW)	-	-	-	-		
DPU-Optionen	NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220	NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220	<ul style="list-style-type: none"> NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220 NVIDIA Bluefield-3 1 x 400 GbE B3140H 	<ul style="list-style-type: none"> NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220 NVIDIA Bluefield-3 1 x 400 GbE B3140H 	<ul style="list-style-type: none"> NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220 NVIDIA Bluefield-3 1 x 400 GbE B3140H* 	<ul style="list-style-type: none"> NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220 NVIDIA Bluefield-3 1 x 400 GbE B3140H* 	<ul style="list-style-type: none"> NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220 NVIDIA Bluefield-3 1 x 400 GbE B3140H* 	<ul style="list-style-type: none"> NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220 NVIDIA Bluefield-3 1 x 400 GbE B3140H* 	-	-	-	-		
Anschlüsse	<p>Frontschnittstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 2.0 Typ C-Anschluss 1 USB 2.0 Typ A-Anschluss (optional) 1 x Mini-DisplayPort (optional) 1 x DB9 seriell (mit vorderer I/O-Konfiguration) 1 x dedizierter BMC-Ethernet-Port (mit vorderer I/O-Konfiguration) <p>Anschlüsse auf der Rückseite</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x dedizierter BMC-Ethernetanschluss 2 x USB 3.1 Typ-A-Anschlüsse 1 x VGA <p>Interne Anschlüsse</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1-Typ-A-Anschluss 	<p>Frontschnittstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB 2.0 Type-C (Host/BMC Direct) 1 x USB 2.0 Type-A (optional LCP – sekundäres KVM) 1 x Mini-DisplayPort (optional LCP – sekundäres KVM) 1 x DB9 seriell (mit vorderer I/O-Konfiguration) 1 x dedizierter BMC-Ethernet-Port (mit vorderer I/O-Konfiguration) <p>Anschlüsse auf der Rückseite</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x dedizierter BMC-Ethernetanschluss 2 USB 3.1 Type-A 1 x VGA <p>Interner Anschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Type-A 	<p>Anschlüsse auf der Vorderseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 2.0 Typ C-Port 1 USB 2.0 Typ A-Anschluss (optional) 1 x Mini-DisplayPort (optional) 1 x DB9 seriell (mit vorderer I/O-Konfiguration) 1 x dedizierter Ethernet-Anschluss für iDRAC-Management <p>Anschlüsse auf der Rückseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x dedizierter Ethernet-Anschluss für iDRAC-Management 1 x VGA 2 x USB 3.1 Typ-A-Anschlüsse <p>Interne Anschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1-Typ-A-Anschluss 	<p>Anschlüsse auf der Vorderseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 2.0 Typ C-Port 1 x USB 2.0 Typ A-Anschluss (optional) 1 x Mini-DisplayPort (optional) 1 x DB9 seriell (mit vorderer I/O-Konfiguration) 1 x dedizierter Ethernet-Anschluss für iDRAC-Management <p>Anschlüsse auf der Rückseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x dedizierter Ethernet-Anschluss für iDRAC-Management 1 x VGA 2 x USB 3.1 Typ-A-Anschlüsse <p>Interne Anschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1-Typ-A-Anschluss 	<p>Anschlüsse auf der Vorderseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 2.0 Type-A (optional LCP KVM) 1 x USB 2.0 Type-C (Host/BMC Direct) 1 x MiniDisplayPort (optional LCP KVM) <p>Anschlüsse auf der Rückseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x dedizierter Ethernet-Anschluss für iDRAC-Management 1 x VGA 2 x USB 3.1 Typ A 1 x VGA <p>Interne Anschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Typ-A-Anschluss 	<p>Anschlüsse auf der Vorderseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB 2.0 Typ C-Port 1 x dedizierter Ethernet-Anschluss für iDRAC-Management 1 x VGA 2 x USB 3.1 Typ-A-Anschlüsse <p>Interne Anschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1-Typ-A-Anschluss 	<p>Anschlüsse auf der Vorderseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB 2.0 Type-A (optional LCP KVM) 1 x USB 2.0 Type-C (Host/BMC Direct) 1 x MiniDisplayPort (optional LCP KVM) <p>Anschlüsse auf der Rückseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x dedizierter Ethernet-Anschluss für iDRAC-Management 1 x VGA 2 x USB 3.1 Typ A 1 x VGA <p>Interne Anschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Typ-A-Anschluss 	<p>Anschlüsse auf der Vorderseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB 2.0 Type-A (optional LCP KVM) 1 x USB 2.0 Type-C (Host/BMC Direct) 1 x MiniDisplayPort (optional LCP KVM) <p>Anschlüsse auf der Rückseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x dedizierter Ethernet-Anschluss für iDRAC-Management 1 x VGA 2 x USB 3.1 Typ A 1 x VGA <p>Interne Anschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Typ-A-Anschluss 	<p>Anschlüsse auf der Vorderseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB 2.0 Type-A (optional LCP KVM) 1 x USB 2.0 Type-C (Host/BMC Direct) 1 x Mini-DisplayPort (optional LCP – sekundäres KVM) <p>Anschlüsse auf der Rückseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x dedizierter BMC-Ethernetanschluss 2 USB 3.1 Type-A 1 x VGA <p>Interner Anschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Type-A 	<p>Anschlüsse auf der Vorderseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB 2.0 Type-A (optional LCP KVM) 1 x USB 2.0 Type-C (Host/BMC Direct) 1 x Mini-DisplayPort (optional LCP-KVM) <p>Anschlüsse auf der Rückseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x dedizierter BMC-Ethernetanschluss 2 USB 3.1 Type-A 1 x VGA <p>Interner Anschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Type-A 	<p>Anschlüsse auf der Vorderseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB 2.0 Type-A (optional LCP KVM) 1 x USB 2.0 Type-C (Host/BMC Direct) 1 x Mini-DisplayPort (optional LCP-KVM) <p>Anschlüsse auf der Rückseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x dedizierter BMC-Ethernetanschluss 2 USB 3.1 Type-A 1 x VGA <p>Interner Anschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Type-A 	<p>Anschlüsse auf der Vorderseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB 2.0 Type-A (optional LCP – sekundäres KVM) 1 x USB 2.0 Type-C (Host/BMC Direct) 1 x Mini-DisplayPort (optional LCP – sekundäres KVM) <p>Anschlüsse auf der Rückseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x dedizierter BMC-Ethernetanschluss 2 USB 3.1 Type-A 1 x VGA <p>Interner Anschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Type-A 	<p>Anschlüsse auf der Vorderseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB 2.0 Type-A (optional LCP KVM) 1 x USB 2.0 Type-C (Host/BMC Direct) 1 x MiniDisplayPort (optional LCP KVM) <p>Anschlüsse auf der Rückseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x dedizierter Ethernet-Anschluss für iDRAC-Management 1 x VGA 2 x USB 3.1 Typ A 1 x VGA <p>Interne Anschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Typ-A-Anschluss 	<p>Anschlüsse auf der Vorderseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB 2.0 Type-A (optional LCP KVM) 1 x USB 2.0 Type-C (Host/BMC Direct) 1 x MiniDisplayPort (optional LCP KVM) <p>Anschlüsse auf der Rückseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x dedizierter Ethernet-Anschluss für iDRAC-Management 1 x VGA 2 x USB 3.1 Typ A 1 x VGA <p>Interne Anschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.1 Typ-A-Anschluss











Funktion	R470	R570	R670	R770	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R770AP	R4715	R5715
PCle-Steckplätze	<p>Bis zu 4 Gen5 PCIe-Steckplätze (x16-Anschlüsse)</p> <ul style="list-style-type: none"> Steckplatz 1: 1 x8 Gen5, niedriges Profil Steckplatz 1: 1 x16 Gen 5 (x16-Anschluss), volle Höhe, halbe Länge auf hinterem Riser Steckplatz 4: 1 x16 Gen 5 (x16-Anschluss), volle Höhe, halbe Länge auf hinterem Riser Steckplatz 31: 1 x16 Gen 5 (x16-Anschluss), volle Höhe, halbe Länge auf hinterem Riser Steckplatz 32: 1 x16 Gen 5 (x16-Anschluss), volle Höhe, halbe Länge auf hinterem Riser 	<p>Bis zu sechs PCIe-Steckplätze (x16-Anschluss)</p> <ul style="list-style-type: none"> Steckplatz 2: 1 x16 Gen5 (gesamte Höhe, halbe Länge) oder 1 x16 (gesamte Höhe, gesamte Länge) Steckplatz 3: 1 x16 Gen5 (gesamte Höhe, halbe Länge) Steckplatz 4: 1 x16 Gen5 (gesamte Höhe, halbe Länge)* oder 1 x16 (gesamte Höhe, gesamte Länge) oder 1 x16 OCP3.0 Steckplatz 6: 1 x4 Gen4 Boss (optional) Steckplatz 7: 1 x16 Gen5 (gesamte Höhe, halbe Länge) oder 1 x16 (gesamte Höhe, gesamte Länge) Steckplatz 9: 1 x16 Gen5 (gesamte Höhe, halbe Länge) Steckplatz 10: 1 x16 OCP3.0 Steckplatz 31: 1 x16 Gen5 (gesamte Höhe, halbe Länge) Steckplatz 34: 1 x16 OCP3.0 oder 1 x4 Gen4 Boss (optional) Steckplatz 36: 1 x16 Gen5 (gesamte Höhe, halbe Länge) Steckplatz 38: 1 x16 OCP3.0 	<ul style="list-style-type: none"> Bis zu zwei PCIe-Steckplätze (x16-Anschlüsse) Steckplatz 31 1 x 16 gesamte Höhe – halbe Länge oder gesamte Höhe – gesamte Länge oder 1 x 16 OCP 3.0 auf dem vorderen Riser Steckplatz 32 1 x 16 gesamte Höhe – halbe Länge oder gesamte Höhe – gesamte Länge oder 1 x 16 OCP 3.0 auf dem vorderen Riser Bis zu acht PCIe-Steckplätze (x8- und x16-Anschlüsse) Steckplatz 1 1 x 8 Gen5 gesamte Höhe – halbe Länge Steckplatz 2 1 x 16 Gen5 doppelte Breite gesamte Länge oder 1 x 8 Gen5 gesamte Höhe – halbe Länge Steckplatz 2 1 x 16 oder 1 x 8 flaches Profil – halbe Länge oder 1 x 16 OCP 3.0 Steckplatz 4 1 x 16 gesamte Höhe – halbe Länge oder 1 x 16 flaches Profil – halbe Länge 	<ul style="list-style-type: none"> Bis zu zwei PCIe-Steckplätze (x16-Anschlüsse) Steckplatz 31 1 x 16 Gen5 gesamte Höhe – halbe Länge auf dem vorderen Riser Steckplatz 36 1 x 16 Gen 5 gesamte Höhe – halbe Länge auf dem vorderen Riser Bis zu acht PCIe-Steckplätze (x8- und x16-Anschlüsse) Steckplatz 1 1 x 8 Gen5 gesamte Höhe – halbe Länge Steckplatz 2 1 x 16 Gen5 doppelte Breite gesamte Länge oder 1 x 8 Gen5 gesamte Höhe – halbe Länge oder 1 x 8 oder 1 x 16 OCP 3.0 Steckplatz 5 2 x 16 Gen5 gesamte Höhe – halbe Länge oder 1 x 8 Gen5 gesamte Höhe – halbe Länge Steckplatz 7 1 x 16 Gen5 gesamte Höhe – halbe Länge oder 1 x 16 Gen5 doppelte Breite gesamte Länge oder 1 x 8 Gen5 gesamte Höhe – halbe Länge Steckplatz 8 1 x 16 Gen5 gesamte Höhe – halbe Länge oder 1 x 8 Gen5 gesamte Höhe – halbe Länge Steckplatz 9 1 x 16 Gen5 gesamte Höhe – halbe Länge oder 1 x 8 Gen5 gesamte Höhe – halbe Länge oder 1 x 16 flaches Profil – halbe Länge 	<p>Bis zu drei PCIe-Steckplätze (x16-Anschluss)</p> <ul style="list-style-type: none"> Steckplatz 1: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder flaches Profil Steckplatz 2: 1 x16 Gen5, flaches Profil oder 1 x16 OCP 3.0 Steckplatz 4: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder flaches Profil 	<p>Bis zu acht PCIe-Steckplätze (x16-Anschlüsse)</p> <ul style="list-style-type: none"> Steckplatz 1: 1 x16 Gen 5, gesamte Höhe Steckplatz 2: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder 1 x16 doppelte Breite, gesamte Länge Steckplatz 3: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder flaches Profil Steckplatz 4: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder 1 x16 doppelte Breite, gesamte Länge oder 1 x16 OCP 3.0 Steckplatz 5: 1 x16 Gen 5, gesamte Höhe Steckplatz 7: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder 1 x16 doppelte Breite, gesamte Länge Steckplatz 8: 1 x16 Gen 5, gesamte Höhe Steckplatz 9: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder flaches Profil 	<p>Bis zu drei PCIe-Steckplätze (x16-Anschluss)</p> <ul style="list-style-type: none"> Steckplatz 1: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder flaches Profil Steckplatz 2: 1 x16 Gen5, flaches Profil oder 1 x16 OCP 3.0 Steckplatz 4: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder flaches Profil 	<p>Bis zu acht PCIe-Steckplätze (x8- oder x16-Anschluss)</p> <ul style="list-style-type: none"> Steckplatz 1: 1 x8 Gen 5, gesamte Höhe Steckplatz 2: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder 1 x8 Gen5 gesamte Höhe oder 1 x16 doppelte Breite, gesamte Länge Steckplatz 3: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder flaches Profil Steckplatz 4: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder 1 x8 Gen5 gesamte Höhe oder 1 x16 OCP3.0 Steckplatz 5: 1 x8 Gen 5, gesamte Höhe Steckplatz 7: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder 1 x8 Gen5 gesamte Höhe oder 1 x16 doppelte Breite, gesamte Länge Steckplatz 8: 1 x16 Gen5 gesamte Höhe oder 1 x8 Gen5 gesamte Höhe Steckplatz 9: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder flaches Profil 	<p>Bis zu 5 Gen5 PCIe-Steckplätze (x16-Anschlüsse)*</p> <ul style="list-style-type: none"> Steckplatz 2: 1 x16 Gen 5, gesamte Höhe Steckplatz 3: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder 1 x16 Gen5, flaches Profil Steckplatz 4: 1 x16 Gen 5, gesamte Höhe* Steckplatz 7: 1 x16 Gen 5, gesamte Höhe Steckplatz 8: 1 x16 Gen 5, gesamte Höhe Steckplatz 9: 1 x16 Gen5 (niedriges Profil) 	<p>Bis zu fünf* PCIe-Steckplätze (x16-Anschlüsse)</p> <ul style="list-style-type: none"> Steckplatz 2: 1 x16 Gen5 (x16-Anschluss), gesamte Höhe, halbe Länge Steckplatz 3: 1 x16 Gen5 (x16-Anschluss), gesamte Höhe oder flaches Profil, halbe Länge Steckplatz 9: 1 x16 Gen5 (x16-Anschluss), gesamte Höhe oder flaches Profil, halbe Länge Steckplatz 7: 1 x16 Gen5 (x16-Anschluss), gesamte Höhe, halbe Länge Steckplatz 5: 1 x16 Gen5 (x16-Anschluss), gesamte Höhe, halbe Länge 	<p>Bis zu drei PCIe-Steckplätze (x16-Anschluss)</p> <ul style="list-style-type: none"> Steckplatz 1: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder flaches Profil Steckplatz 2: 1 x16 Gen5, flaches Profil oder 1 x16 OCP 3.0 Steckplatz 4: 1 x16 Gen5, gesamte Höhe oder flaches Profil 	<p>Bis zu drei PCIe-Steckplätze (x16-Anschluss)</p> <ul style="list-style-type: none"> Steckplatz 2: 1 x16 Gen 5, gesamte Höhe Steckplatz 3: 1 x16 Gen 5, gesamte Höhe Steckplatz 7: 1 x16 Gen 5, gesamte Höhe Steckplatz 9: 1 x16 Gen 5, gesamte Höhe
Gen5 PCIe-Steckplätze	4	4.	3	8	3	8	3	8	5*	5	3	4.





Funktion	R470	R570	R670	R770	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R770AP	R4715	R5715
Betriebs-system und Hypervisors	<ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu Server LTS • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi • Windows-Server • Windows Server Datacenter Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport .	<ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server mit Hyper-V • RedHat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport .	<ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server mit Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi • Dell NativeEdge OS* Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport .	<ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server mit Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi • Dell NativeEdge OS* Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport .	<ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server mit Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport .	<ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server mit Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport .	<ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server mit Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport .	<ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server mit Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport .	<ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server mit Hyper-V* • RedHat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • SUSE Linux Enterprise Server • VMware vSAN/ESXi* • Microsoft Windows 2025 Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport .	<ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server mit Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport .	<ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server mit Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport .	
OEM Ready-Version erhältlich	Von der Blende über das BIOS bis hin zur Verpackung – Ihre Server können aussehen wie von Ihnen entworfene und gefertigte Produkte. Weitere Informationen erhalten Sie unter Dell.com/OEM .											





Hinweis: * Funktionen, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind bei der Produkteinführung möglicherweise nicht verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter [Dell.com](https://www.dell.com).

Informationen zum Kauf von Dell PowerEdge-Servern finden Sie unter [Dell.com](https://www.dell.com).

Weitere Informationen zu plattformspezifischen Spezifikationen und weiteren Details finden Sie im technischen Handbuch auf [Dell.com](https://www.dell.com).

Rack-Server	R260	R360	R660	R760	R860	R960	R660xs	R760xs	R760xd2	R760xa
										
Wichtige Attribute	Rack-Server mit geringer Tiefe und Filterblende für Near-Edge-KundInnen mit den neuesten Intel® Xeon® Prozessoren der 6300 Serie, DDR5-Arbeitspeicher, NVMe BOSS und Energy Star 4.0-Netzteil	Optimierte Produktivität, Enterprise-GPU und leistungsstarke Rechenleistung für gängige Geschäftsanwendungen.	Bietet Leistung und Vielseitigkeit für anspruchsvolle Anwendungen	Bietet Leistung und Vielseitigkeit für anspruchsvolle Anwendungen	Unterstützung geschäftskritischer Core-Workloads mit Rechenleistung mit hoher Dichte	Extreme Beschleunigung für Business Continuity und Scale-out	Richtige Größe für die gängigsten IT-Anwendungen	Richtige Größe für die gängigsten IT-Anwendungen	Hohe Speicherdichte, schnellerer Abruf und Skalierbarkeit	Leistungsstarker, skalierbarer Server für intensive GPU-Anwendungen
Ziel-Workloads	Zusammenarbeit und Freigabe, E-Mail und Messaging, Near-Edge-Anwendungen	Zusammenarbeit und Freigabe, E-Mail und Messaging, Datenbank	Virtualisierung und Datenbankanalysen mit hoher Dichte, Standardisierung gemischter Workloads	Standardisierung gemischter Workloads, Datenbank und Analysen, virtuelle Desktopinfrastruktur	Große In-Memory-Datenbanken, Datenanalysen, KI und Virtualisierung, virtuelle Desktopinfrastruktur (VDI)	Virtualisierung, Cloud, Scale-Out-Datenbank, High Performance Computing (HPC)	Virtualisierung, Software Defined Storage, VM oder VDI mit mittlerer Dichte	Datei- und Objektspeicher, Videoaufnahme und Überwachung, Videostreaming	KI/ML/DL-Training und Inferencing Digitale Zwillinge, Rendern von Grafiken Virtualisierung und VDI-Grafik	
Prozessortypen	1 Intel® Xeon® Prozessor der 6300 Serie mit bis zu 8 Cores oder 1 Intel® Xeon® Prozessor der E-2400 Serie mit bis zu 8 Cores oder 1 Intel® Pentium Prozessor mit 2 Cores	1 Intel® Xeon® Prozessor der 6300 Serie mit bis zu 8 Cores oder 1 Intel® Xeon® Prozessor der E-2400 Serie mit bis zu 8 Cores oder 1 Intel® Pentium Prozessor mit 2 Cores	2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation, bis zu 56 Cores pro Prozessor oder 2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation, bis zu 64 Cores pro Prozessor	4 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation mit bis zu 60 Cores pro Prozessor und optionaler Intel® QuickAssist Technologie	2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 28 Cores oder 2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessor der 4. Generation, bis zu 32 Cores pro Prozessor	2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation, bis zu 32 Cores pro Prozessor oder 2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation; bis zu 28 Cores pro Prozessor	2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation, bis zu 56 Cores pro Prozessor oder 2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation, bis zu 64 Cores pro Prozessor			
DDR5-DIMM-Steckplätze (max. Kapazität)	4 (128 GB)	4 (128 GB)	32 (8 TB)	64 (16 TB)	16 (1,5 TB)	16 (1,5 TB)	16 (1,5 TB)	32 (8 TB)		
Festplattenlaufwerke bis:	2 x 3,5 Zoll 6 x 2,5 Zoll 4 x 2,5"-Chip-SATA-SSD (SW-RAID) 4 x 2,5"-Chip-SATA + 2 x 2,5"-NVMe (SW-RAID) 4 x 2,5"-SAS/SATA + 2 x 2,5"-NVMe (HW-RAID)	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 6 x 2,5"-SAS/SATA + 2 x 2,5"-NVMe	8 x 2,5" 10 x 2,5" 10 x 2,5" 14 x E3.S 16 x E3.S 2 x 2,5 Zoll (hinten) 2 x E3.S (hinten)	12 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll 24 x 2,5 Zoll 8 x E3.S 2 x 2,5 Zoll (hinten) 16 x E3.S 8 x 2,5 Zoll + 16 x E3.S	8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll 24 x 2,5 Zoll 8 x E3.S 2 x 2,5 Zoll (hinten)	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 10 x 2,5 Zoll 2 x 2,5 Zoll (hinten)	12 x 3,5 Zoll 8 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll + 8 x NVMe 2 x 2,5 Zoll (hinten)	12 x 3,5 Zoll (vorderer Schacht) + 12 x 3,5 Zoll (mittlerer Schacht) 2 x 2,5 Zoll oder 4 x 2,5 Zoll oder 4 x 3,5 Zoll oder 4 x E3.S (hinten)	6 x 2,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 6 x E3.S	
NVMe Laufwerke bis zu:	2	2	10	24	24	24	10	8	4.	8
Gen5 PCIe-Steckplätze bis zu:	k. A.	2	2	4.	8	12	2	2	k. A.	12
Gen4 PCIe-Steckplätze bis zu:	2	2	3	8	4.	k. A.	3	4.	5	k. A.
Accelerator-Unterstützung bis zu:	k. A.	1 x 60 W SW	3 x 75 W SW	2 x 350W DW oder 6 x 75W SW	k. A.	4 x 400 W DW	k. A.	2 x 75 W SW	2 x 75 W SW, 1 x 75 W SW + 1 x 150 W SW oder 1 x 180 W DW	4 x 400W DW oder 12 x 75W SW
Rack-Höhe (U)	1	1	1	2	2	4.	1	2	2	2
Integrierte Sicherheit	TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, TPM 2.0 China NationZ, kryptografisch signierte Firmware, Alarm bei Gehäuseeinbruch, Secure Boot als Standardsicherheit, Silicon Root of Trust, Systemsperre (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Datacenter), Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement), gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) und Systemlöschung auf allen Racks.									

Rack-Server	R7625	R6625	R7615	R6615
				
Wichtige Attribute	Bahnbrechende Leistung	Bahnbrechende Leistung	Hohe Leistung und Skalierbarkeit	Spitzenleistung und hervorragende Gesamtbetriebskosten
Ziel-Workloads	High Performance Computing (HPC), Virtual Desktop Infrastructure (VDI), Virtualisierung	High Performance Computing (HPC), Virtual Desktop Infrastructure (VDI), Virtualisierung	Software Defined Storage (SDS), Virtualisierung, Datenanalysen	Virtualisierung, Hyper-Converged Infrastructure (HCI), Network Functions Virtualization (NFV)
Prozessortypen	Zwei AMD EPYC™ Prozessoren der 4. Generation der 9004 Serie, bis zu 128 Cores pro Prozessor	Zwei AMD EPYC™ Prozessoren der 4. Generation der 9004 Serie, bis zu 128 Cores pro Prozessor	1 AMD EPYC™ Prozessor der 4. Generation der 9004 Serie, bis zu 128 Cores	
DDR5-DIMM-Steckplätze (max. Kapazität)	24 (6 TB)	24 (6 TB)	12 (3 TB)	
Festplattenlaufwerke bis:	8 x 3,5 Zoll 12 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll 24 x 2,5 Zoll 2 x 2,5 Zoll (hinten) 4 x 2,5 Zoll (hinten) 4 x E3.S (hinten)	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 10 x 2,5 Zoll 14 x E3.S 16 x E3.S 2 x 2,5 Zoll (hinten) 2 x E3.S (hinten)	8 x 3,5 Zoll 12 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll 24 x 2,5 Zoll 2 x 2,5 Zoll (hinten) 4 x 2,5 Zoll (hinten) 4 x E3.S (hinten)	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 10 x 2,5 Zoll 14 x E3.S 16 x E3.S 2 x 2,5 Zoll (hinten) 2 x E3.S (hinten)
NVMe Laufwerke bis zu:	24	10	24	10
Gen5 PCIe-Steckplätze bis zu:	4	2	4.	2
Gen4 PCIe-Steckplätze bis zu:	8	3	4.	3
Accelerator-Unterstützung bis zu:	2 x 300W DW oder 6 x 75W SW	3 x 75 W SW	3 x 300W DW oder 6 x 75W SW	3 x 75 W SW
Rack-Höhe (U)	2	1	2	1
Integrierte Sicherheit	TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, TPM 2.0 China NationZ, kryptografisch signierte Firmware, Alarm bei Gehäuseeinbruch, Secure Boot als Standardsicherheit, Silicon Root of Trust, Systemsperre (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Datacenter), Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement), gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) und Systemlöschung auf allen Racks.	TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, TPM 2.0 China NationZ, kryptografisch signierte Firmware, Secure Boot, Secure Erase, Silicon Root of Trust, Systemsperre (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Datacenter), AMD Secure Memory Encryption (SME) und AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV)		

Rack-Server	R450	R550	R650	R750
				
Wichtige Attribute	Wert- und dichteorientiert, entwickelt für universelle IT-Anwendungen	Vielseitig, wertoptimiert, geeignet für Virtualisierung, entwickelt für universelle IT-Anwendungen	Hohe Skalierbarkeit, optimierte Workload-Performance	Hervorragende Performance für die anspruchsvollsten Workloads
Ziel-Workloads	Kleine IT-Infrastruktur, leichte VM, typische Workloads für kleine Unternehmen	Kleine IT-Infrastruktur, leichte VM-Dichte, typische Workloads für kleine Unternehmen	Gemischte Workload-Standardisierung, Datenbanken und Analysen, HFT, herkömmliche IT-, VDI-, HPC-, KI oder ML-Umgebungen in Unternehmen	Datenbanken und Analysen, HPC, herkömmliche IT-, VDI-, KI- oder ML-Umgebungen in Unternehmen
Prozessortypen	2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 3. Generation, bis zu 24 Cores pro Prozessor		Zwei Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 3. Generation, bis zu 40 Cores pro Prozessor	
DDR4-DIMM-Steckplätze (max. Kapazität)	16 (1 TB)	16 (1 TB)	32 (4 TB)	32 (8 TB)
Festplattenlaufwerke bis:	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll	8 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 10 x 2,5 Zoll 2 x 2,5 Zoll (hinten)	12 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll 24 x 2,5 Zoll 2x 2,5 Zoll oder 4 x 2,5 Zoll (hinten)
NVMe Laufwerke bis zu:	k. A.	k. A.	12	24
Gen4 PCIe-Steckplätze bis zu:	2	3	3	8
Gen3 PCIe-Steckplätze bis zu:	k. A.	1	k. A.	k. A.
Accelerator-Unterstützung bis zu:	k. A.	k. A.	3 x 75 W SW	2 x 300 W DW oder 4 x 150 W SW oder 6 x 75 W SW
Rack-Höhe (U)	1	2	1	2
Integrierte Sicherheit	TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, TPM 2.0 China NationZ, kryptografisch signierte Firmware, Gehäuseeingriffswarnung und sicherer Start als Standardsicherheit auf allen Racks. Integrierte Sicherheitsfunktionen wie Silicon Root of Trust, System Lockdown (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Datacenter) und System Erase auf allen Racks			

Nachhaltig

Von recycelten Materialien in unseren Produkten und Verpackungen bis hin zu durchdachten, innovativen Optionen für Energieeffizienz – das PowerEdge-Portfolio wurde entwickelt, um Produkte herzustellen, bereitzustellen und zu recyceln, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und Ihre Betriebskosten zu senken. Mit Dell Technologies erleichtern wir sogar die verantwortungsbewusste Stilllegung von veralteten Systemen.

Erfahren Sie mehr über PowerEdge-Server.



[Weitere Informationen](#) zu Dell Networking-Lösungen



[Kontaktieren Sie](#) das Dell Technologies Expertenteam



[Weitere Ressourcen](#) anzeigen



[Folgen Sie uns](#) auf Dell.com



[Folgen Sie uns](#) auf X



[Folgen Sie uns](#) auf LinkedIn

Reden Sie mit:
#DellTechnologies

Eine umfassende Liste finden Sie unter www.dell.com/PowerEdge. Die Verfügbarkeit der Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich an Ihren Dell Vertriebsmitarbeiter, um weitere Informationen zu erhalten.

Copyright © Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.